课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
 - 研究半导体中载流子数目在不同温度下的行为
- 第四部分: 载流子输运
- 第五部分: 非平衡载流子

第三章: 大纲

- 回顾热力学里温度的概念 (复习)
- 电子系统中温度和能量分布的关系
 - 费米分布
 - 态密度(复习第二章)
 - 本征半导体中的载流子浓度
 - 掺杂半导体中的载流子浓度
- 霍耳效应 (教材12.1)

半导体的载流子浓度

玻尔兹曼

<u></u>导带电子浓度 $n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$

导带C: 状态数VNc

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

Nn: 受主浓度

价带V: 态密度VN_v

N_v: 价带等效状态浓度

电子数VN_cf(E_c)

电子数VN_Df_D(E_D)

简并因子修正过的费米分布

电子数VNafa(Ea) 空穴数VN_A(1-f_A(E_A))

> 电子数VN_vf(E_v) 空穴数VN_v(1-f(E_v))

V: 半导体体积

<u>价带空穴浓度</u> $p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$

要求:非简并 – E_c 、 E_v 和 E_F 足够远(>几个 k_B T,"几"至少要有2.5)

小结: 本征半导体

• 未掺杂 (掺杂补偿) 半导体

电子-空穴浓度乘积

$$np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = \frac{(m_{dn}^* m_{dp}^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

- 本征载流子浓度n_i与材料和 温度有关
- 同一材料,随温度升高而迅速增大
- 同一温度下,Eg越大,ni越小

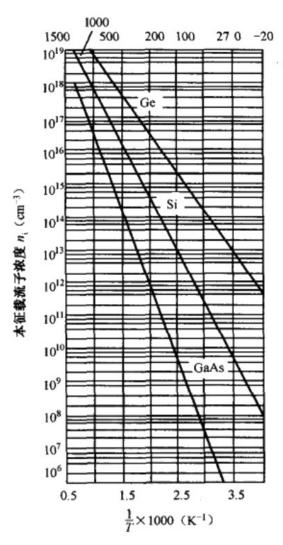


图 3-7 硅、锗、砷化镓 的 $\ln n_i \sim 1/T$ 关系^[5]

小结: n型掺杂半导体

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区(饱和)
- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区
- •注意:空穴浓度在非简并条件下一直都可以用np=n_i²计算

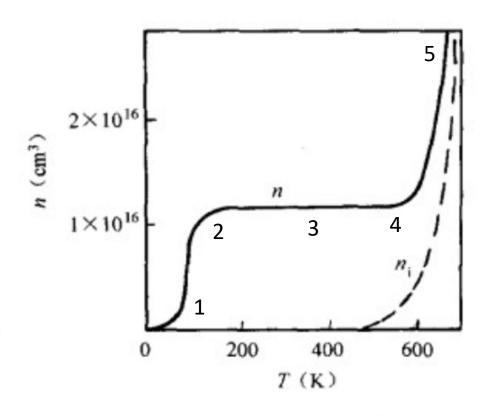
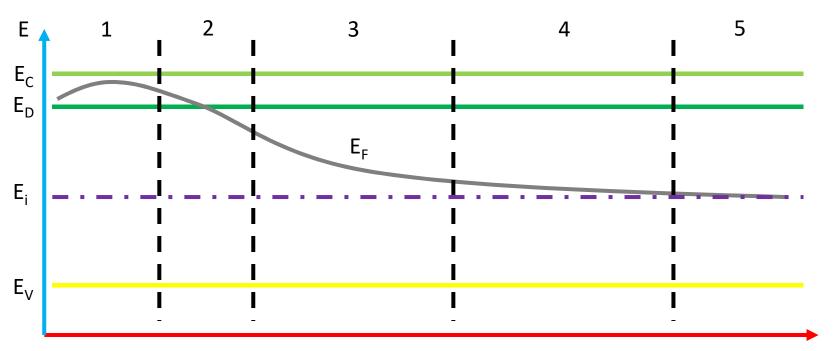


图 3-11 n型硅的电子浓度与 温度的关系^[8,9]曲线

n型半导体的费米能级

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区

- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区



p型半导体的载流子浓度

$$p = n + (N_A - p_A)$$

- 分情况讨论:温度从低到高
- T=0, 无激发
- 低温,依照感性认识,受主容易激发,价带导带激发可忽略: $n << N_A p_A$, $p = N_A p_A$
 - 1. 低温弱电离区(杂质电离也很弱)
 - 2. 中间电离区
 - 3. 强电离区(杂质完全电离)
- 高温,价带导带激发不可忽略
 - 4. 过渡区(n ~ N_A p_A)
 - 5. 高温本征激发区 (n >> N_A-p_A, n = p)

$$p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} \qquad p_A = \frac{N_A}{\frac{1}{g_A} e^{\frac{E_F - E_A}{k_B T}} + 1} \qquad \text{电中性条件} \qquad p = N_A - p_A$$

$$N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = p = N_A - p_A = \frac{N_A}{g_A e^{-\frac{E_F - E_A}{k_B T}} + 1}$$

1.2.3.三个区域的通解为
$$E_F = -k_B T \log \left(\frac{\sqrt{1 + \frac{4g_A N_A}{N_V} e^{\frac{E_A - E_V}{k_B T}}} - 1}{2g_A} \right) + E_A$$

$$p = \frac{N_V}{2g_A} e^{-\frac{E_A - E_V}{k_B T}} (\sqrt{1 + \frac{4g_A N_A}{N_V} e^{\frac{E_A - E_V}{k_B T}}} - 1)$$

| 表 3-2 | 300K | 下锗、 | 硅、 | 砷化镓 | 的本征载流子浓度 |
|-------|------|-----|----|-----|----------|
|-------|------|-----|----|-----|----------|

| 各项参数 | $E_{\rm g}({\rm eV})$ | $m_n^* (m_{dn})$ | $m_p^* (m_{dp})$ | $N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$ | $N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$ | n _i (cm ⁻³) (计算值) | n _i (cm ⁻³)(測量值) |
|------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| Ge | 0.67 | $0.56m_0$ | $0.29m_0$ | 1.05×10 ¹⁹ | 3.9×10 ¹⁸ | 1.7×10 ¹³ | 2.33×10 ¹³ |
| Si | 1.12 | $1.062m_0$ | $0.59m_0$ | 2.8×10 ¹⁹ | 1.1×10 ¹⁹ | 7.8×10 ⁹ | 1.02×10^{10} |
| GaAs | 1.428 | $0.068m_0$ | $0.47m_0$ | 4.5×10 ¹⁷ | 8.1×10 ¹⁸ | 2.3×10 ⁶ | 1.1×10 ⁷ |

• 对于硅,取N_A=1e16 cm⁻³,N_V(300 K)=1e19 cm⁻³,E_A-E_V=50 meV,可算得

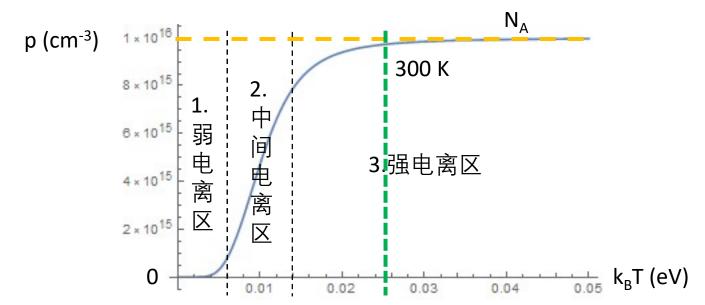


表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流子浓度

| 各项参数 | $E_{\rm g}({\rm eV})$ | $m_n^* (m_{dn})$ | $m_p^*(m_{dp})$ | $N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$ | $N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$ | n _i (cm ⁻³) (计算值) | n _i (cm ⁻³) (測量值) |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Ge | 0.67 | $0.56m_0$ | $0.29m_0$ | 1.05×10 ¹⁹ | 3.9×10^{18} | 1.7×10 ¹³ | 2.33×10^{13} |
| Si | 1.12 | $1.062m_0$ | $0.59m_0$ | 2.8×10 ¹⁹ | 1.1×10 ¹⁹ | 7.8×10 ⁹ | 1.02×10^{10} |
| GaAs | 1.428 | $0.068m_0$ | $0.47m_0$ | 4.5×10 ¹⁷ | 8.1×10^{18} | 2.3×10 ⁶ | 1.1×10 ⁷ |

在哪个区域的判定标准

$$p = \frac{N_V}{2g_A} e^{-\frac{E_A - E_V}{k_B T}} (\sqrt{1 + \frac{4g_A N_A}{N_V} e^{\frac{E_A - E_V}{k_B T}}} - 1)$$

T比较小,
$$\frac{4g_AN_A}{N_V}e^{\frac{E_A-E_V}{k_BT}}\gg 1$$
 $p\sim \left(\frac{N_VN_A}{g_A}\right)^{1/2}e^{-\frac{E_A-E_V}{2k_BT}}$ 为弱电离区

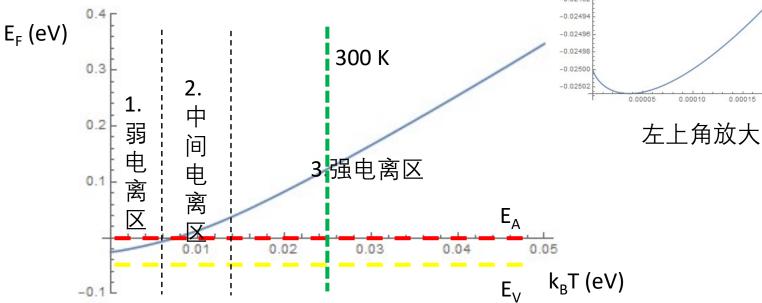
T比较大,
$$\frac{4g_A N_A}{N_V} e^{\frac{E_A - E_V}{k_B T}} \ll 1$$
 $p \sim \frac{N_V}{2g_A} e^{-\frac{E_A - E_V}{k_B T}} \left(1 + \frac{2g_A N_A}{N_V} e^{\frac{E_A - E_V}{k_B T}} - 1\right) = N_A$ 为强电离区

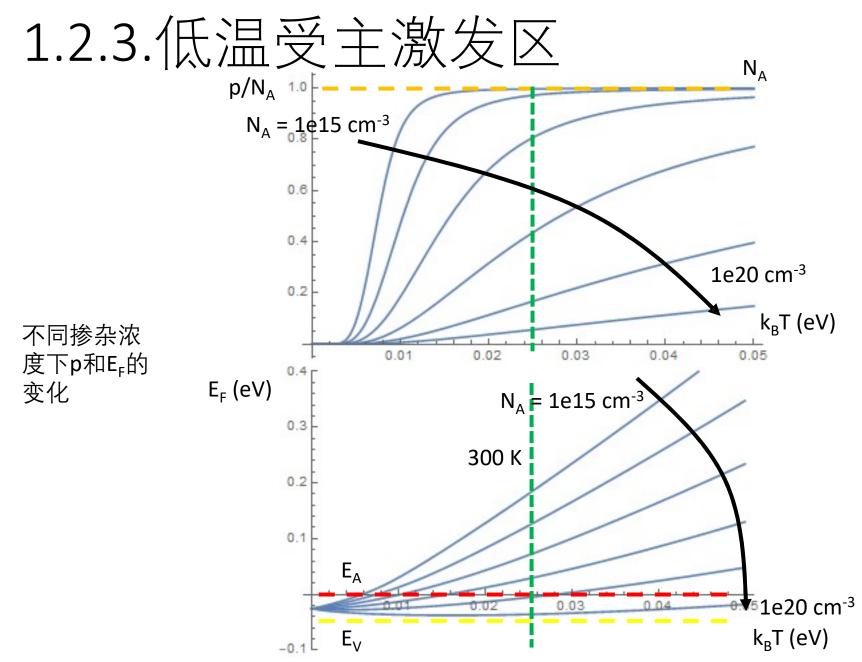
表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流子浓度

| 各项参数 | $E_{\rm g}({ m eV})$ | $m_{\rm n}^* (m_{\rm dn})$ | $m_p^* (m_{dp})$ | $N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$ | $N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$ | n _i (cm ⁻³) (计算值) | n _i (cm ⁻³)(测量值) |
|------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| Ge | 0.67 | $0.56m_0$ | $0.29m_0$ | 1.05×10 ¹⁹ | 3.9×10 ¹⁸ | 1.7×10 ¹³ | 2.33×10 ¹³ |
| Si | 1.12 | $1.062m_0$ | $0.59m_0$ | 2.8×10 ¹⁹ | 1.1×10 ¹⁹ | 7.8×10 ⁹ | 1.02×10^{10} |
| GaAs | 1.428 | $0.068m_0$ | $0.47m_0$ | 4.5×10 ¹⁷ | 8.1×10 ¹⁸ | 2.3×10 ⁶ | 1.1×10 ⁷ |

• 对于硅,取N_A=1e16 cm⁻³,N_V(300 K)=1e19

cm⁻³,E_A-E_V=50 meV,可算得





4.5. 高温价带导带激发区

价带空穴浓度 $p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$ 受主能级空穴浓度 $p_A = 0$

导带电子浓度
$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$

电中性条件
$$p = (N_A - p_A) + n = N_A + n$$

$$N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = p = N_A + n = N_A + N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$

注意:
$$np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{k_B T}}$$
 还是成立

此时可直接解一元二次方程 $p = N_A + n_i^2/p$,得到

$$p = \frac{N_A}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}} \right) \qquad n = p - N_A = \frac{N_A}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}} \right)$$

也可算出
$$E_F = E_i - k_B T \operatorname{arcsh} \frac{N_A}{2n_i} = \frac{1}{2} \left(E_C + E_V - k_B T \log \frac{N_C}{N_V} \right) - k_B T \operatorname{arcsh} \frac{N_A}{2n_i}$$

4.5. 高温价带导带激发区

$$p = \frac{N_A}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}} \right) \qquad n = p - N_A = \frac{N_A}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}} \right)$$
如果温度较低 $N_A \gg 2n_i \qquad (n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{k_B T}})$
则 $p \sim \frac{N_A}{2} \left(1 + 1 + \frac{2n_i^2}{N_A^2} \right) = N_A + \frac{n_i^2}{N_A} \qquad n = p - N_A \sim \frac{n_i^2}{N_A}$

即:电子浓度约等于施主浓度+本征激发浓度,空穴浓度约等于本征激发浓度→过渡区

如果温度较高 $N_A \ll 2n_i$

$$\text{III} \qquad p = \frac{N_A}{2} \left(1 + \frac{2n_i}{N_A} \right) \sim \frac{N_A}{2} + n_i \qquad n = p - N_A \sim -\frac{N_A}{2} + n_i$$

即: 电子、空穴浓度约等于本征激发浓度→本征激发区

此时
$$E_F = E_i - k_B T \operatorname{arcsh} \frac{N_A}{2n_i} \sim E_i$$
 靠近本征费米能级 E_i

小结: p型掺杂半导体

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区
- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区
- •注意:电子浓度在非简并条件下一直都可以用np=n_i²计算

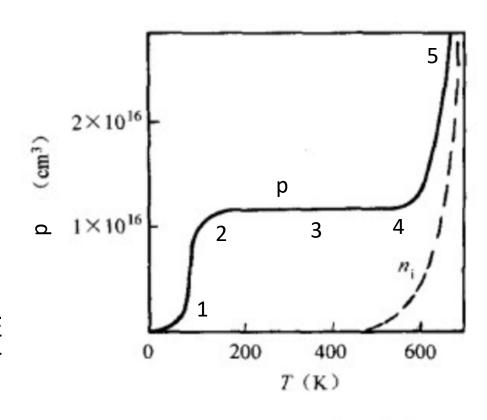
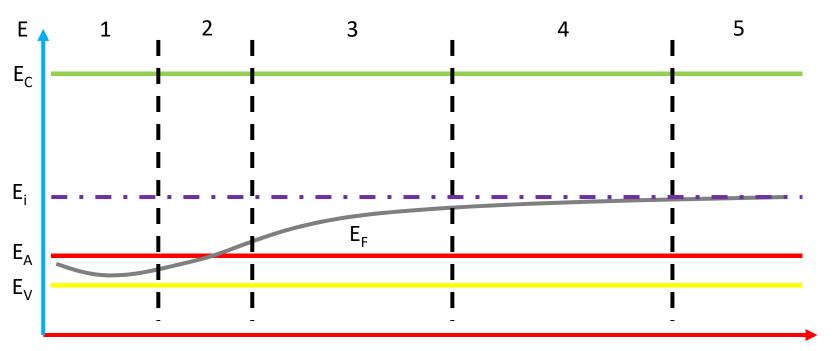


图 3-11 P 型硅的电子浓度与 温度的关系^[8,9]曲线

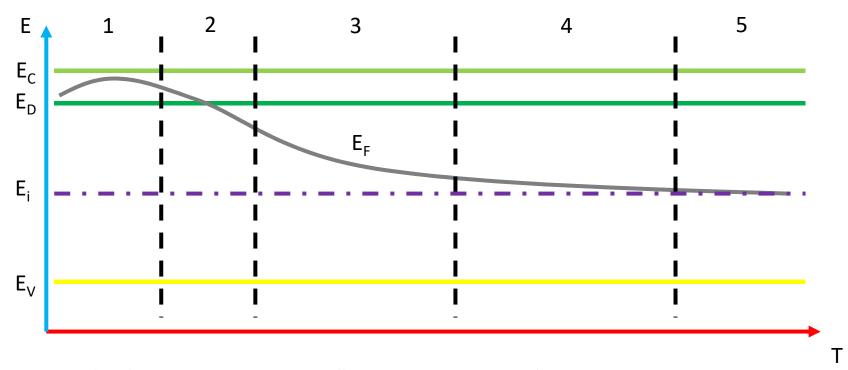
p型半导体的费米能级

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区

- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区



掺杂半导体的非简并条件



非简并条件:导带、价带费米分布能近似为玻尔兹曼分布,便于积分

$$E_C - E_F > 2.5k_BT$$
 $E_V - E_F < -2.5k_BT$

对常见半导体,在3.饱和区、4.过渡区、5本征激发区能满足非简并条件 在室温下,通常半导体能满足非简并条件,但重掺杂半导体不满足,称为简并半导体

简并半导体

- <u>如果掺杂浓度很高,E_F将非常靠近带边,甚至进入能带;此时必须应用费米分布函数。相应的半</u>导体称为简并半导体
- 非简并半导体:可应用玻尔兹曼近似
 - $E_C E_F > 2.5 k_B T$
 - $E_F E_V > 2.5 k_B T$
- 弱简并: 2.5k_BT ≥ E_C-E_F (E_F-E_V) > 0
- 简并: E_C-E_F (E_F-E_V) ≤ 0

简并半导体: 重掺杂

• 类氢原子波函数交叠,形成能带

氢原子



玻尔半径 (波函数大致的延展半径)

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar}{me^2}$$

53 pm

类氢原子

玻尔半径

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r\hbar}{m^*e^2}$$

硅中电子? ~ 2000 pm

杂质很多时, 类氢原子的波函数会重叠

简并半导体: 重掺杂

• 类氢原子波函数交叠,形成能带

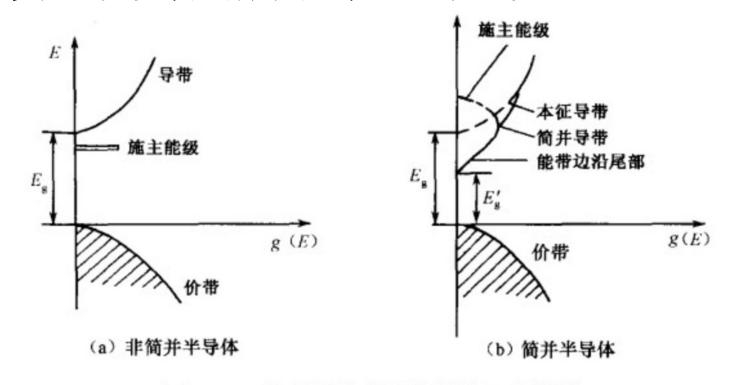


图 3-19 状态密度g(E)与能量 E 的关系

禁带变窄; E_F进入能带中

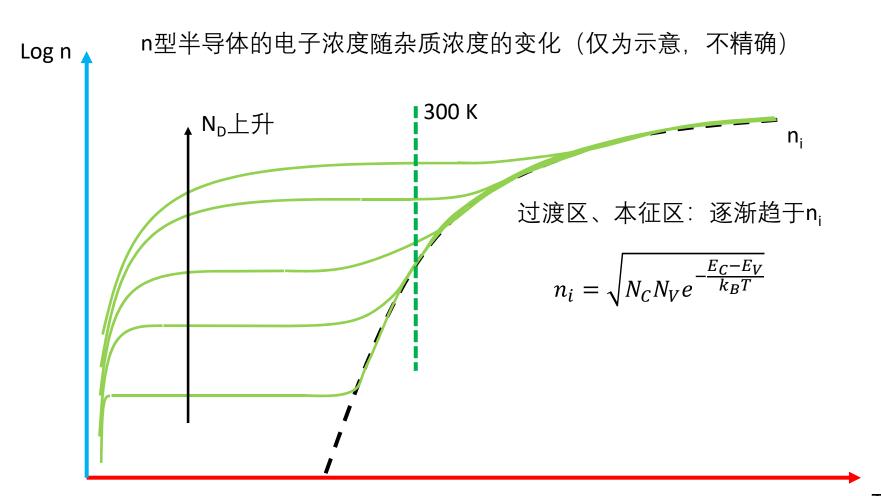
简并半导体: 重掺杂

- 掺杂浓度很高时,虽然按照非简并条件,半导体室温时理应处于中间电离区或弱电离区
- 但由于形成杂质能带和导带/价带相连,因此杂质能级上的电子/空穴也能运动,也是载流子
- 因此,不管轻掺杂或者重掺杂,室温时,常见半导体(如硅、砷化镓),只要不进入本征区(过渡区),载流子浓度都比较接近于 N_D 或 N_A

n、p和EF随杂质浓度的变化

- 掺有某种杂质的半导体,其载流子浓度和E_F由温度和掺杂浓度所决定。
- 前面主要讨论了随温度的变化
- 一确定的半导体,在一定温度下(如300 K),载流子浓度和E_F由杂质浓度决定:
 - 载流子浓度随掺杂浓度的变化:掺杂浓度较高时,掺杂越多,载流子浓度越高,但难达到饱和;掺杂浓度 较低则进入本征区
 - E_F随掺杂浓度的变化:掺杂浓度越高,E_F越靠近带边

n随杂质浓度的变化示意图



n、p和E_F随杂质浓度的变化

室温时的n、p和N_D、N_A的关系

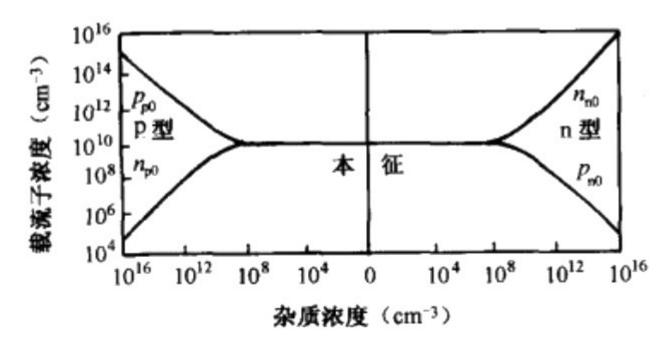


图 3-14 硅中载流子浓度与杂质浓度的关系

掺杂在一开始不影响载流子浓度。超过本征浓度之后,掺得越多载流子浓度越高

n、p和EF随杂质浓度的变化

- 掺有某种杂质的半导体,其载流子浓度和E_F由温度和掺杂浓度所决定。
- 前面主要讨论了随温度的变化
- 一确定的半导体,在一定温度下(如300 K),载流子浓度和E_F由杂质浓度决定:
 - 载流子浓度随掺杂浓度的变化:掺杂浓度较高时,掺杂越多,载流子浓度越高,但难达到饱和;掺杂浓度 较低则进入本征区
 - E_F随掺杂浓度的变化:掺杂浓度越高,E_F越靠近带边

n、p和EF随杂质浓度的变化

掺杂浓度越高,载流子浓度越高 掺杂浓度越高, E_F越靠近带边

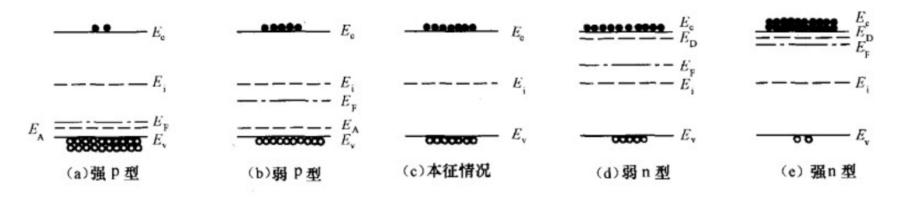


图 3-13 不同掺杂情况下的半导体的费米能级

小结: 掺杂半导体

- 载流子浓度受到温度和掺杂浓度共同影响
- 随温度变化, 主要分为五个区域
 - 1. 低温弱电离区(杂质电离也很弱)
 - 2. 中间电离区
 - 3. 强电离区(饱和,杂质完全电离)
 - 4. 讨渡区
 - 5. 高温本征激发区
- 随掺杂浓度变化
 - 超过本征载流子浓度时,掺杂浓度越高,载流子浓度越高,E_F越靠近带边
 - 室温通常处于强电离区,载流子浓度=掺杂浓度

多子和少子

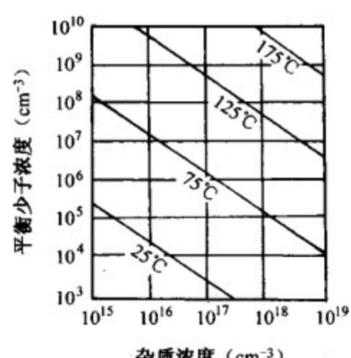
- 弱电离区、中间电离区、强电离区、过渡区n≠p
- 一种载流子多,一种载流子少
- 多的称为<u>多数载流子/多子</u>,少的称为<u>少数载流</u>子/少子
- 多子是载流的主要部分

强电离区少子浓度

- 多子浓度=掺杂浓度
- 少子浓度=n_i²/掺杂浓度
 - 在饱和区的温度范围内, 由于多子浓度基本不变, 因此少子浓度将随着温度 的升高而迅速增大

n_i2的表达式为

$$np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$
 图 3-15 不同温度下,平衡



杂质浓度 (cm-3)

少子浓度与杂质浓度的关系

例题: 半导体的少子浓度

表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流子浓度

| 各项参数 | $E_{\rm g}({\rm eV})$ | $m_n^*(m_{dn})$ | $m_p^*(m_{dp})$ | $N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$ | $N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$ | n _i (cm ⁻³) (计算值) | n _i (cm ⁻³)(測量值) |
|------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| Ge | 0.67 | $0.56m_0$ | $0.29m_0$ | 1.05×10 ¹⁹ | 3.9×10^{18} | 1.7×10 ¹³ | 2.33×10^{13} |
| Si | 1.12 | $1.062m_0$ | $0.59m_0$ | 2.8×10 ¹⁹ | 1.1×10 ¹⁹ | 7.8×10 ⁹ | 1.02×10^{10} |
| GaAs | 1.428 | $0.068m_0$ | $0.47m_0$ | 4.5×10 ¹⁷ | 8.1×10 ¹⁸ | 2.3×10 ⁶ | 1.1×10 ⁷ |

• 求多子浓度为10¹⁵ cm⁻³时,Ge、Si、GaAs的少子浓度。

半导体带隙随温度的变化

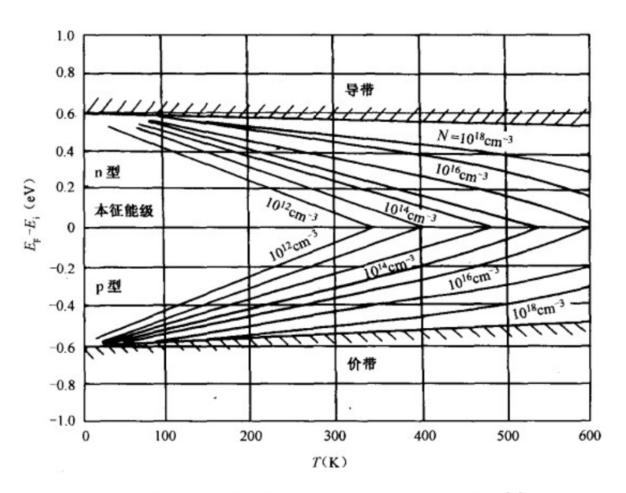


图 3-10 硅的费米能级与温度及杂质浓度的关系[5]

半导体带隙随温度的变化

最后指出,硅、锗的禁带宽度是随温度变化的。在 T=0K 时,硅、锗的禁带宽度 $E_{\rm g}$ 分别趋近于 $1.170{\rm eV}$ 和 $0.7437{\rm eV}$ 。随着温度升高, $E_{\rm g}$ 按如下规律减小

$$E_{\rm g}(T) = E_{\rm g}(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$
 (1-66)

式中, $E_g(T)$ 和 $E_g(0)$ 分别表示温度为 T 和 0K 时的禁带宽度。温度系数 α 和 β 分别为

硅:
$$\alpha = 4.73 \times 10^{-4}$$
 eV/K

$$\beta = 636K$$

锗:
$$\alpha = 4.774 \times 10^{-4} \text{ eV/K}$$

$$\beta = 235K$$

原因: 晶格振动导致周期势发生变化

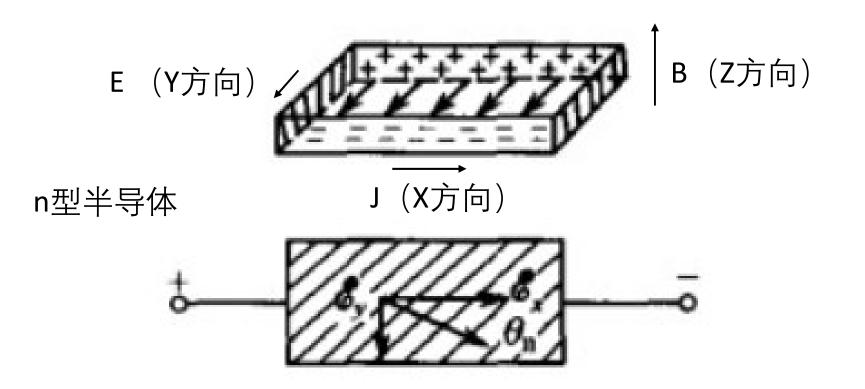
这些理论如何用实验验证?

第三章: 大纲

- 回顾热力学里温度的概念(复习)
- 电子系统中温度和能量分布的关系
 - 费米分布
 - 态密度(复习第二章)
 - 本征半导体中的载流子浓度
 - 掺杂半导体中的载流子浓度
- 霍耳效应 (教材12.1)

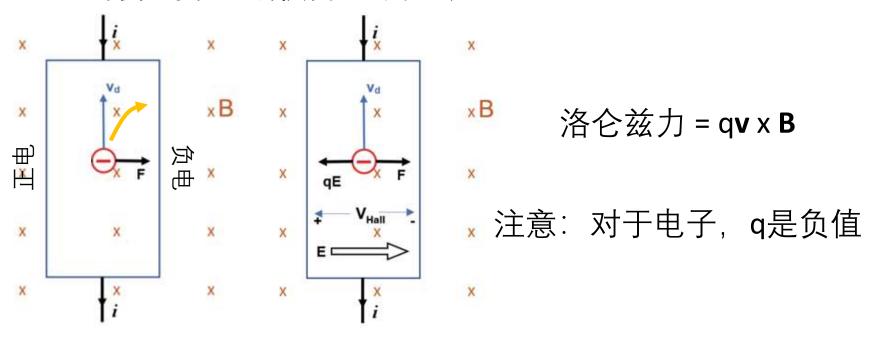
霍耳效应:现象

通有电流的半导体,置于均匀磁场中,磁场方向与电流方向垂直,则半导体中将产生一横向电场,即霍耳电场。



霍耳效应:产生原因

- 简化模型
 - 载流子受到洛仑兹力而发生偏转,从而在横向造成电荷积累,形成横向电场/电压



• 根本原因:和费米能级对应的等能面(费米面) 形状有关,Berry相位(略)

不同载流子的霍耳效应

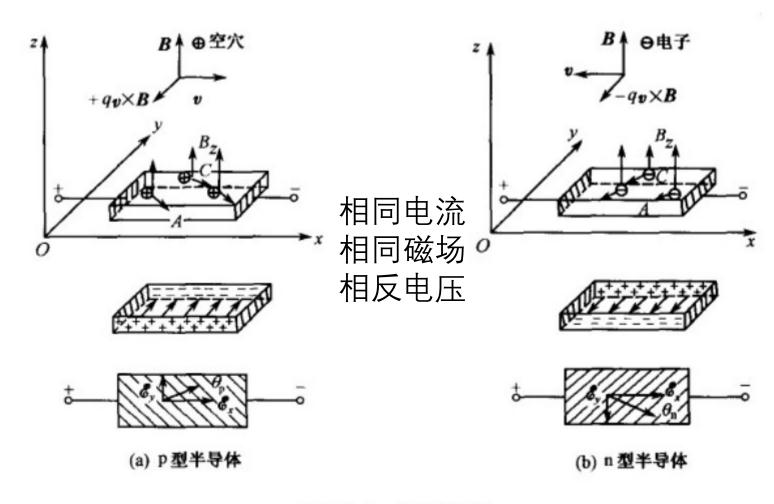
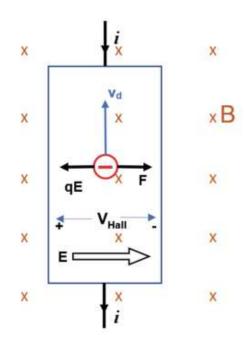


图 12-1 霍耳效应

霍耳效应: 定量描述



稳态时有力平衡方程

$$q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

考虑E、v、B均垂直,故

$$E = vB$$

又有

$$J=\pm nqv$$

 $J = \pm nqv$ n为载流子浓度

因此

$$E = \frac{JB}{\pm nq} = R_H JB$$

其中R_H = 1/±nq, 称为霍耳系数

载流子为空穴时取正号, R_H>0; 为电子时R_H<0

霍耳效应:实验测量

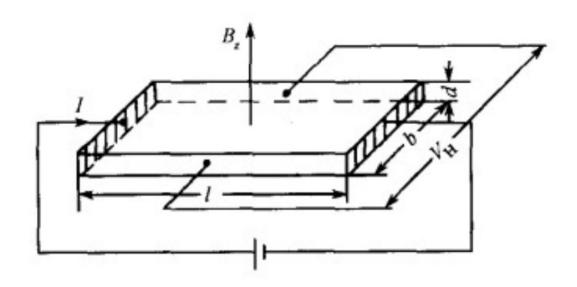
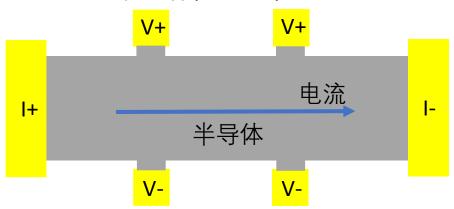


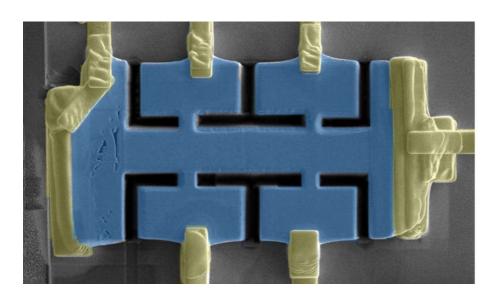
图 12-2 测量霍耳系数的示意图

$$R_H = \frac{E}{JB} = \frac{V_H/b}{IB/bd} = \frac{V_Hd}{IB}$$

霍耳效应: 实验测量

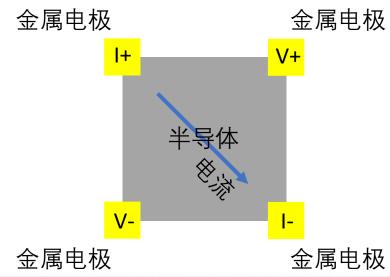
霍耳棒(Hall bar)测量法

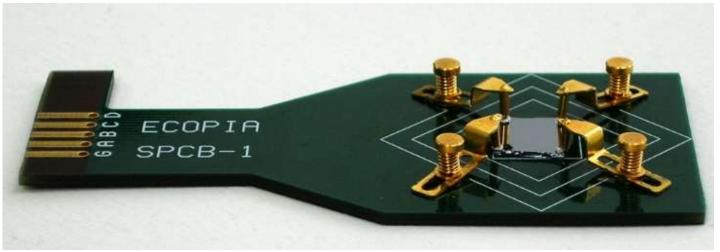




霍耳效应: 实验测量

范德坡(van der Pauw)测量法





霍耳效应的应用

• 直接测量载流子类型和浓度

$$E = \frac{JB}{\pm nq} = R_H JB = \frac{V_H d}{IB}$$

- 已知载流子类型和浓度,可用于测量未知磁感强度
 - "高斯计":磁场传感器

习题

- 1. 推出锗导带、价带的态密度表达式。请利用电子纵向、横向有效质量,重空穴、轻空穴有效质量表示。
- 2. 假设硅中施主浓度为 N_D 、受主浓度为 N_A , $N_D=N_A$,两者能级差为 ΔE 。求在温度T时能级的占据情况。只考虑施主能级、受主能级,不考虑价带导带。请使用简并因子、非简并条件。
- 3. 题设如第二题。假设ΔE约等于1 eV, 求300 K 时杂质的补偿率(即,有百分之多少的杂质被补偿了)。如果想要明显偏离完全补偿(例如补偿率99%以下),需要多高的温度?

习题

- 4. 如果想在300 K时得到电子浓度为10¹⁷ cm⁻³的锗,可以怎样掺磷? 施主能级取10 meV。
- 5. 在p型硅中掺入B, $N_A=10^{15}$ cm⁻³。求在50 K、300 K、350 K时空穴和电子的浓度。这些情况都对应什么区? 受主能级取50 meV。
- 6. 考虑p型硅的中间电离区。当 $E_A=E_F$ 时,受主电离率是多少?说明理由。

习题

• 7. 室温300 K下,本征GaAs、n型GaAs(N_D=10¹⁶ cm⁻³)、p型GaAs(N_A=10¹⁶ cm⁻³)的费米能级各在哪里?

• 8. 有一片未知半导体(200 μm厚度),加上向右的电流I=1 mA和垂直于纸面向里的磁场**B**=2000 Oe后,观察到上正下负的电压1.6 mV。求载流

子类型和数目。

